

製造業を 支える レーザー微細 加工技術

SEMINAR in HAMAMATSU

2024
10/31 木

参加費無料

🕒 13:30-15:30 (開場13:00)

近年のレーザー業界は、従来装置では加工が難しかった素材や、高集積化により、これまで以上の加工精度が要求される半導体部品に対応した機器が開発されるなど、加工技術で製造業を裏から支える存在に成長しています。本セミナーでは、第1部でレーザー微細加工技術の最新動向を紹介し、第2部でレーザー加工機を導入して事業化に成功した事例を紹介します。また、講演後は県内の支援施策や浜松工業技術支援センターのレーザー施設についても紹介・見学を行います。

会場

浜松工業技術支援センター
大研修室
浜松市浜名区新都田一丁目3-3

定員
50名

講演内容

第1部

製造業を支える レーザー微細加工技術

- ・レーザー精密微細加工の技術の紹介
- ・レーザー精密微細加工の応用例
- ・電子産業への応用例

講師

光産業創成大学院大学
客員教授

日野 敦司 氏

第2部

レーザーを用いた シボ加工機導入の事例紹介

- ・金型へのシボ加工技術や加工例の紹介
- ・レーザー加工とエッチング加工との比較
- ・レーザー加工機導入の経緯、
事業化成功のポイント

講師

株式会社ワールドエッチング
代表取締役社長

山本 景太 氏

製造業を支える レーザー微細加工技術

参加費
無料

講演概要

▼ 第1部

製造業を支える レーザー微細加工技術

講師
光産業創成大学院大学客員教授
日野 敦司 氏

Profile

1984年九州大学大学院総合理工学研究科修士課程修了、同年日東電気工業株式会社(現 日東電工株式会社)入社、プラスチック材料を中心とした電子材料向けのレーザー微細加工プロセスの開発とそれを応用した製品開発に従事。2012年株式会社レーザーシステム入社、微細加工向けのレーザー装置開発に従事。2019年より光産業創成大学院大学客員教授。



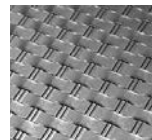
▼ 第2部

レーザーを用いた シボ加工機導入の事例紹介

講師
株式会社ワールドエッチング 代表取締役社長
山本 景太 氏

Profile

1997年株式会社ワールドエッチングへ入社。主にシボ加工の営業を経て、2014年より技術部も兼任。新規加工技術や加工設備の導入検討などを担当。2021年より代表取締役就任。現在に至る。



【その他】▶ 浜松工業技術支援センターのレーザー共用設備の紹介・見学 / 浜松地域の光・電子技術支援施策の紹介

お申込み方法

WEBまたは
FAX(下記にご記入)にて
お申込みください

WEB <https://www.hai.or.jp/pvc/event/241031seminar/> ▶

FAX **053-471-2113**



お申込み
締切
2024
10/28 月

お問い合わせ ▶ 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 フォトンバレーセンター(担当:工藤) TEL:053-471-2111

ご参加にあたってのお願い

- ・セミナー終了後、主催者及び講師等からアンケートを実施しますのでご協力をお願いします。
- ・応募多数の場合、調整させていただく場合がございます。

参加申込書

会社	企業・団体名			
	住所	〒		
	TEL			
参加者 1	氏名			所属部署・役職名
	E-mail			
参加者 2	氏名			所属部署・役職名
	E-mail			

個人情報保護に関する注意事項

申込書にご記入いただいた個人情報は、当財団の事業等に関する情報提供や参加者募集の案内以外では使用いたしません。また目的外に使用したり第三者に提供したりすることはありません。